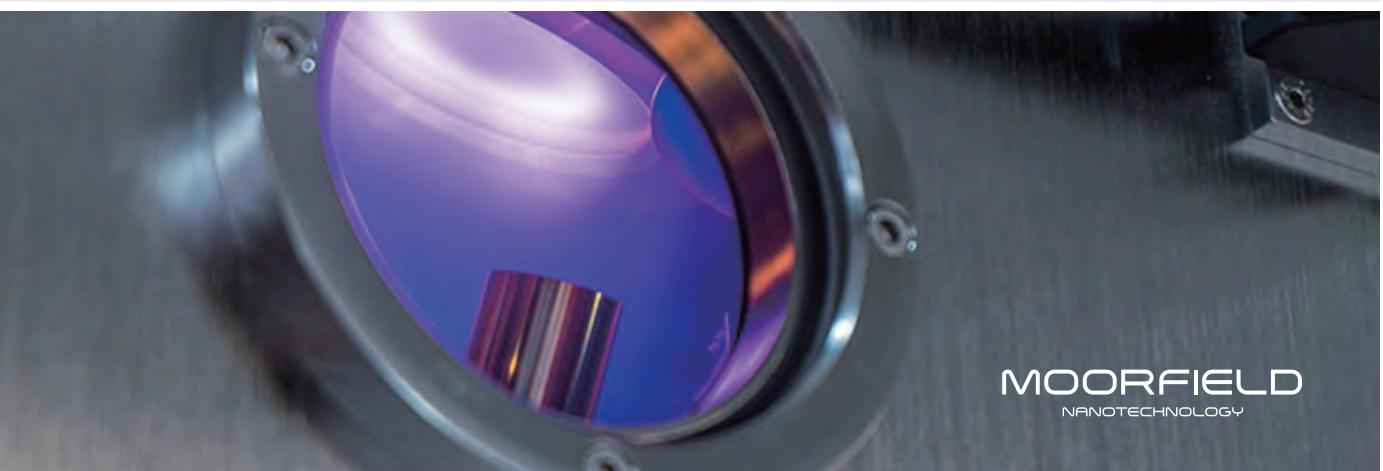


## Thin Film Deposition

MOORFIELD  
NANOTECHNOLOGY



# MiniLab-S125A multi-cathode sputtering system

MiniLab-S125A【多元マルチスパッタ装置】

【6元マルチスパッタ装置(Φ2inchカソード)】

【4元マルチスパッタ装置(Φ4inchカソード)】

コンパクトサイズ (1,767 x 754mm) システムに、カソード最大 4 元、又は 6 元搭載、多元マルチスパッタ装置。連続多層膜、同時成膜 (2~6 元同時成膜)、抵抗加熱蒸着・有機蒸着・EB・ドライエッ칭、PECVD、アニールなどの混在構成も可能です。



### Load Lock チャンバー

- RIEプラズマエッティングステージ  
メインチャンバー、LL室いずれも可能
- RF150W, 300W, 又はDC780W
- <30W低出力制御ソフトエッティング



### マグнетロンスパッタリングカソード

- マルチスパッタカソード(DC, RF兼用)
- 4元同時スパッタ

### MiniLab-S125A 多元マルチスパッタリング装置

寸法:1,767(W) x 754(D) x 1,645(H)mm



### MiniLab-S125A スパッタリング装置

#### 【チャンバー仕様】

- 500(W) x 500(D) x 650(H)
- SUS304フロントローディング式
- Φ90mmビューポート x 1(又は2)
- 到達真空度 5x10<sup>-5</sup> Pascal

#### 【基板ステージ】

- 4inch～Φ12inch基板対応
- 基板回転(回転速度20段階速度可変式)
- 基板加熱ヒーター  
500°Cハロゲンランプヒーター  
1000°C/Cコンポジット、又はSiCコーティング

#### 【マグネットロンスパッタリング】

- Φ2inchマグネットロンカソード x 最大6元
- Φ3inchカソードの場合 x 最大4元
- Φ4inchカソードの場合 x 最大4元
- 磁性材料用高強度マグネット(オプション)
- 水冷式、傾斜・上下摺動式フレキシブルアングルヘッド

#### 【スパッタ電源】

- RF150W, 300W, 又はDC780W
- HiPIMS電源(PulseDC 5KW)も併設可能

\* プラズマリレー SW で HMI 画面より自在に 6 カソードへの電源分配・配置設定の変更が可能

Windows-PC で一元管理：バルブ操作・成膜操作（カソード ON/OFF・シャッター開閉・回転等）、真空 / パージ等全ての装置操作を PC インターフェイス 1箇所で行いますので、操作が分散しません。



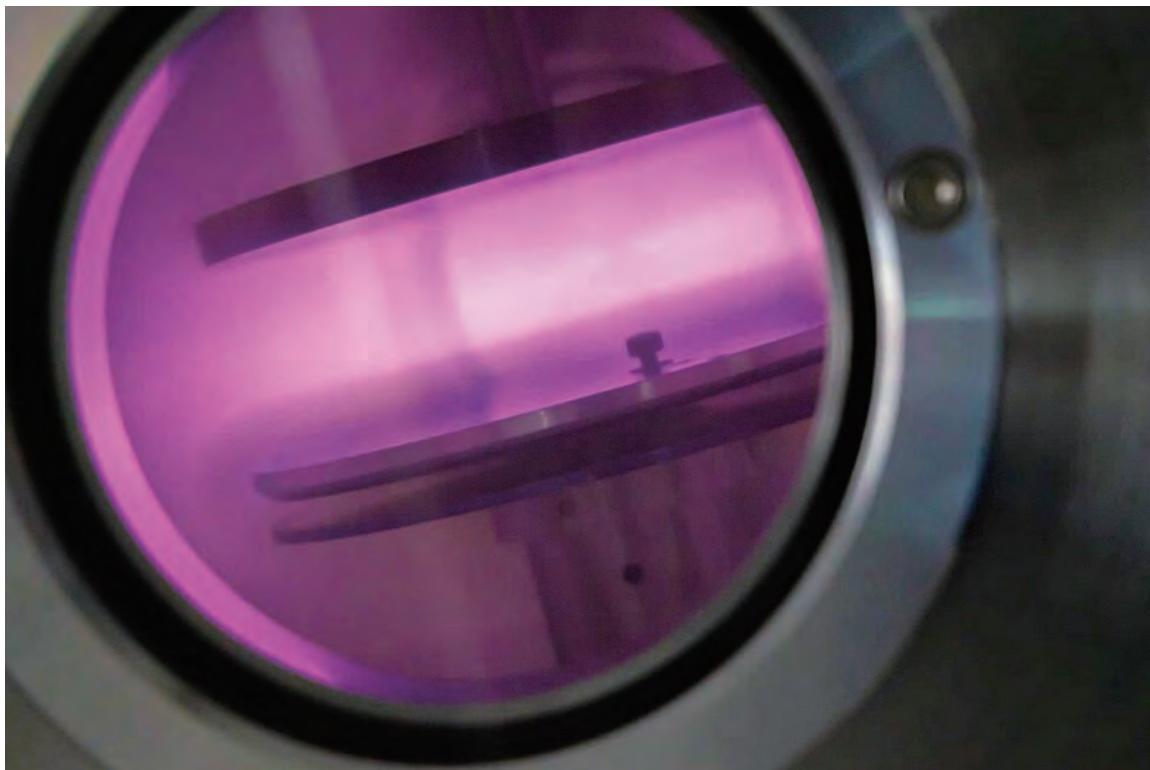
スパッタリングカソード



ロードロック搬送機構



基板加熱ヒーター(SiCコーティング)



RIEプラズマエッティングステージ(メインチャンバー, LL室いずれも可能)

- RF150W, 300W, 又はDC780W
- <30W低出力制御ソフトエッティング

#### 装置外形寸法

